

## AP-200 CMP 化学机械抛光机

韩国 CTS 公司的 AP-200 型 CMP 化学机械抛光机是一款高性能的 CMP 化学机械抛光系统，采用 CTS 公司半导体工业级的设计理念，为科研工作者、CMP 耗材研发生产企业和 CMP 先进工艺开发企业提供了一套符合半导体工业要求的高端设备，可兼容 4 英寸，6 英寸，8 英寸晶片样品。

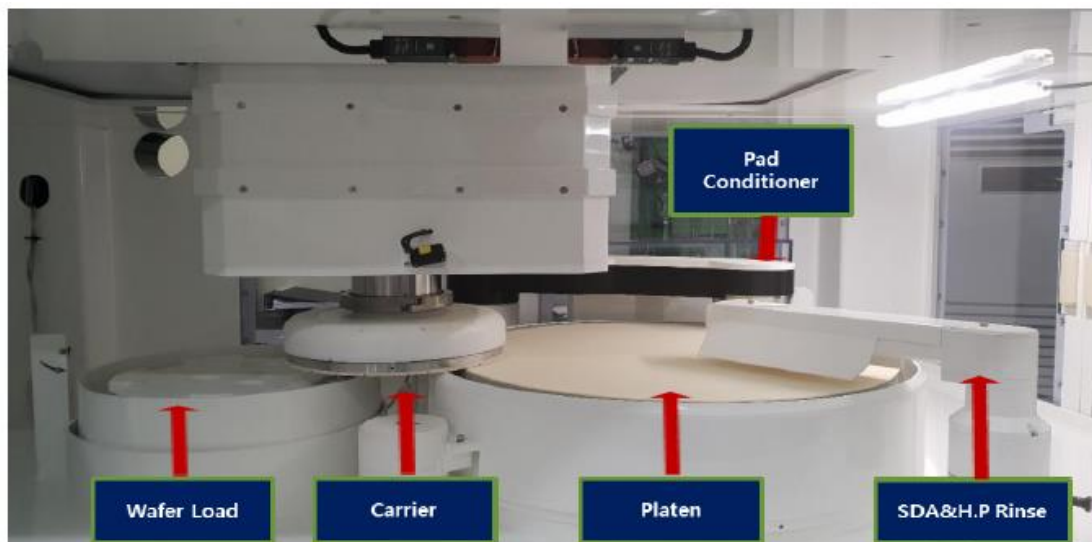
### 产品主要特点：

#### 1. 高性能 CMP 化学机械抛光工艺设计

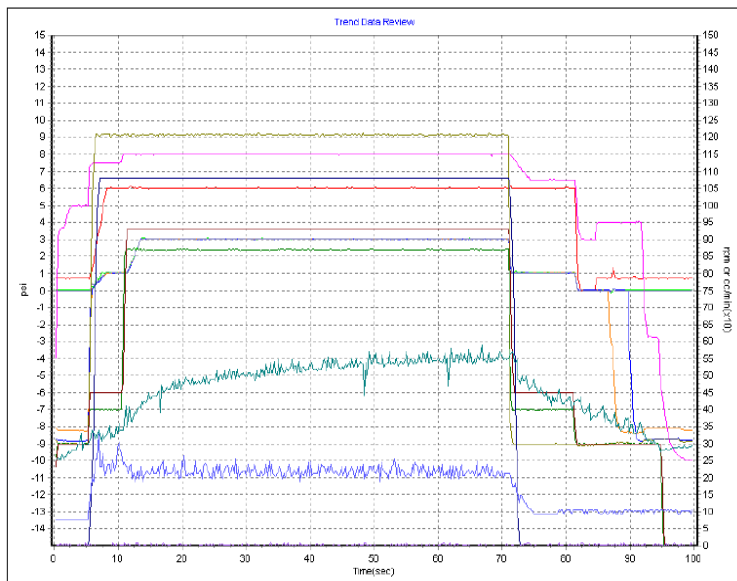
- 研磨垫整理器：可控制 10 区域扫动（19 次来回扫动/分钟）
- 抛光头规律摆动的直线运动
- 膜型抛光头，采用气囊加载模式，核心区，边缘区，保持环三区压力控制，可得到良好的工业级抛光效果
- 10 个孔可调节抛光液的下滴位置
- 低压控制：0.14~14psi
- 可用 100, 150mm 和 200mm 抛光头

### 主要技术参数：

- 抛光平台转速：0-200 rpm
- 抛光头载体转速：0-200 rpm
- 整理器转速：0-150 rpm
- 抛光液流速：20-500 cc/min
- 整理器下压力：2- 20 lbs



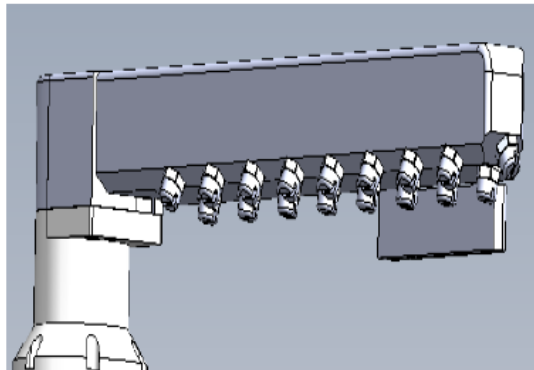
## 2. 工艺数据可实时监测；



- Trend data review
- Wafer pressure
- Conditioner downforce
- Carrier rpm
- Platen rpm
- Conditioner rpm

## 3. 多种抛光液 & 高压去离子水系统

- 内置两个共给抛光液的泵单元
- 抛光液材质：氧化物，钨，铜，二氧化铈等
- 流量：20~500cc / min
- 双排喷嘴排列布置，具有高压清洁效果
- 通过各种不同喷嘴角度，更干净的清洗抛光垫



## 应用领域：

- ILD（层间电介质）CMP，IMD（金属间电介质）CMP，氧化物 CMP，多晶硅 CMP，钨 CMP，铜 CMP
- 半导体 CMP 工序（Semiconductor CMP）
- MEMS CMP
- 高校及科研院所高品质科研测试（University, Lab \_High Quality Performance Test）
- 晶片研磨代工企业（Wafer Polishing Service）
- CMP 耗材研发企业（CMP Consumable Parts），CMP 抛光液，金刚石研磨垫整理器，CMP 研磨垫